

创业邦获悉，电子浆料研发商海宁云荒新材料有限公司（以下简称“云荒”或公司）宣布完成数千万元天使轮融资，本轮由金鼎资本独家投资。云荒本轮融资所得资金将主要用于平台搭建、产品研发、运营管理及市场拓展。

云荒新材成立于2022年，是一家专注于电子元器件专用电子浆料研发、生产及销售的企业。创始团队深耕行业多年，曾在世界500强公司长期任职，有着丰富的行业经验，公司拥有业界领先的电子浆料研发水平及完善的生产工艺know-how。目前公司已推出多款针对小尺寸、抗硫化、抗银迁移、超低阻等不同用途的片式电阻专用导体浆料产品，并已送至下游标杆大客户进行验证，整体反馈良好。公司将陆续针对片式电阻、MLCC、钽电容、射频器件、厚膜集成电路等应用推出一系列解决方案。云荒新材致力于打造国内领先的电子浆料研发生产企业，打破国外企业在中高端电子浆料领域对国内的垄断。

电子浆料是由金属粉、有机载体、玻璃粉等经混合分散研磨均匀而成的一种电子功能复合材料，其产品质量直接影响下游产品性能。其应用广泛，在光伏、电子元器件、半导体封装、柔性显示、高频通信等领域都有巨大市场，全球市场规模超过6000亿元。光伏导电银浆是最大的细分赛道，需求也随着光伏行业的快速发展而不断增加，但目前该领域国产化率较高，国内已实现突破，多家国内企业整体市占率高。被动电子元器件RCL俗称“工业大米”，广泛应用于消费类电子、汽车、医疗、军工、通信等领域，在智能化电气化趋势的推动下，电子元器件的需求量将在未来持续保持高速增长。被动元器件专用电子材料由于整体要求更高，该领域电子浆料主要还是由美国杜邦、日本住友、日本昭和等国际巨头掌控，尤其在工业级、车规级等应用场景更是属于垄断地位。随着国内MLCC、片式电阻等被动元器件厂商崛起，上游原材料亟需实现国产突破。

金鼎资本科技事业部合伙人认为：“电子浆料是个大赛道，虽然光伏领域目前国内厂商林立，也基本实现国产替代，但依然存在较大的结构性机会。我们看好公司在被动元器件用电子浆料这一细分赛道的潜力，云荒团队完善，经验丰富，有着大厂完备的知识储备和体系架构，而且团队核心成员均处于当打之年，富有激情，是一群有闯劲的创业者。我们在与他们多轮的接触交流后，认为公司是有机会在这一领域做出一番事业的，我们也会坚定地支持他们。”

云荒创始人表示：“金鼎是我本轮融资过程中见过的效率最高、决策最快的投资机构，其科技事业部团队对电子元器件产业也具有建设性认识。不管是项目负责人还是机构合伙人都极具创业者的奋斗精神，连续多天高效跟进项目，快速得完成立项、高管访谈、客户尽调以及协议条款的谈判。在融资谈判过程中，就已经整合了丰富的产业资源为公司赋能。云荒新材希望与金鼎资本持续合作，准确找到市场痛点，打造一流的产品技术，力争为国内在被动元器件专用电子材料实现国产替代化贡献一份力量”

本文源自创业邦